

北京科技大学货物与服务单一来源采购论证报告

采购项目	热电薄膜及工艺研究			预算金额 (万元)	40 万元
拟成交 供应商	中国电子科技集团公司第十八研究所				
专家论证 意见 [预算金额 50 万元（不含）以下的，至少需要由 3 位专家进行论证；50 万元（含）以上的，至少需要由 5 位专家进行论证，其中至少有 1 位校外专家]	专家论证意见： 热电晶体管集成电路制备及芯片封装技术复杂，制备难度大、成本极高，我们学校缺少完整的器件封装设施，必需委托有条件单位进行技术合作、加工制备以及时完成项目指标。中国电子科技集团公司第十八研究所能够提供相关的完整的芯片封装技术和装备，可有效帮助我校按时完成相关研究任务。 鉴于以上事实，论证结论是同意支持该外协合作项目。 此外，需要说明的是中国电子科技集团公司第十八研究所是目前国内唯一具有生产热电晶体管芯片的完整配套设施、生产基础和生产经验的单位，因此被甲方指定为单一来源供应单位。				
	论证专家签字：				
	组成	姓名	单位	职称/职务	签字
	组长	周张健	北京科技大学	教授	周张健 年 月 日
	组员	张迎春	北京科技大学	教授	张迎春 年 月 日
	组员	张玉娟	北京科技大学	副教授	张玉娟 年 月 日
	组员				
组员				年 月 日	
其他 需要 说明 情况					

预算金额 10 万元（含）以上，申请采用单一来源方式采购的，需由采购项目负责人组织专家论证并填写此论证报告（含附件），连同采购申请表一并提交。

附：

北京科技大学货物与服务单一来源采购
公示内容

采购项目	热电薄膜及工艺研究	采购项目 负责人	徐桂英
拟采购货物 或服务的 详细说明	委托中国电子科技集团公司第十八研究所在 2025. 3. 1-2025. 5. 30 期间，分 5 批次，每批次 10 个器件，价格是 8 万元/批次，为我们提供热电晶体管器件的制备、芯片封装及其热电性能测试的工作。		
单一来源 采购原因 及 相关说明	热电晶体管集成电路制备及芯片封装技术复杂，制备难度大、成本极高，我们学校缺少完整的器件加工与封装设施，必需委托有条件单位进行技术合作进行器件加工制备、封装和测试以及及时完成项目指标。 中国电子科技集团公司第十八研究所能够提供相关的完整的芯片制造、封装和测试技术和装备，可以按时完成相关技术指标。 还需要特别说明的是中国电子科技集团公司第十八研究所是目前国内唯一具有热电晶体管芯片生产所需的完整的配套设施、生产基础和生产经验的单位，故而被甲方指定为单一来源供应单位。		
拟成交 供应商	名称：中国电子科技集团公司第十八研究所		
	地址：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路 6 号		
公示期限	2025 年 4 月 30 日至 2025 年 5 月 5 日（不少于 5 个日历日）		
招采中心 联系方式	联系地址：北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学招标与采购管理中心货物与服务采购科（办公楼 106 室）		
	联 系 人：马老师	联系电话：010-62332135	

采购项目负责人签字：徐桂英

2025 年 4 月 30 日